

明新學校財團法人明新科技大學 函

機關地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號  
聯絡人：何宗穎  
電子信箱：zyho@must.edu.tw  
聯絡電話：(03)5593142分機3270  
傳真電話：(03)5595142

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國113年5月16日

發文字號：明新（半）字第1130005638號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(2件) 附件如說明一(附件2明新科技大學112學年度教師產業研習活動海報1份  
aca4a311a825b9437b334965898df739\_1131200843\_2\_ATTCH2.png、附件1明新科  
技大學112學年度教師產業研習活動簡章1份  
aca4a311a825b9437b334965898df739\_1131200843\_1\_ATTCH1.pdf)

主旨：有關本校辦理112學年度教師產業研習「半導體封裝技術與核心實務培訓營」第二梯次培訓課程，請轉知貴校工程專業領域之教師報名參加，活動資訊詳如說明，請查照。

說明：

一、旨揭培訓課程由專家學者與業師共同授課，內容包含半導體封裝技術及核心實務兩個部份：封裝製程主要講授封裝技術之衍變所衍生的專業知識；核心實務則提升晶圓切割機、固晶機與打線機之實務操作能力；QFN自動機台操作則是藉由機台、製程參數設定提升機台運轉效能，檢附研習課程之活動簡章（附件1）及活動海報（附件2）。

二、研習相關資訊：

(一)第二梯次：113年7月1日(星期一)至113年7月12日(星期五)，共10天，上午8時30分至下午4時30分。

(二)研習地點：本校逢喜樓209教室、半導體封裝測試類產線基地。



(三)參加培訓人數40人（名額有限滿額為止）。

三、報名方式：

(一)報名時間：113年6月25日截止

(二)報名網址：<https://forms.gle/Wjm3viG6Tv8pvD146>

四、報名洽詢：本校半導體學院類產線計畫辦公室何宗穎助理，電話：(03)5593142分機3270

正本：各公私立高級職業學校、各公私立大專校院

副本：本校半導體學院、本校產學及技術轉移中心、本校電子工程系

113/05/16  
15:19:49

訂

線



# 112學年度教師產業研習 半導體封裝技術與 核心實務培訓營

## 課程簡介

由專家學者與業師共同授課，內容包含半導體封裝技術及核心實務兩個部份。封裝製程主要講授封裝技術的衍變所衍生的專業知識。核心實務則提升晶圓切割機、固晶機與打線機的實務操作能力。QFN自動機台操作則是藉由機台、製程參數設定提升機台運轉的效能。

## 課程時間 / 地點

### 第一梯次

113/01/22(一)至113/02/02(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

### 第二梯次

113/07/01(一)至113/07/12(五)

每週一至五早上8:30至下午16:30

明新科技大學達喜樓(209教室)  
半導體封裝測試類產線基地

## 合作機構及廠商

明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室  
工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組  
力成科技股份有限公司

aca4a311a825b9437b334965898df739\_1131200843\_2.ATTCH2.png

## 參與對象/報名資訊

高中職及大專院校教師

報名時間：113年6月25日截止

報名網址：

<https://forms.gle/Wjm3viG6Tv8pvD146>

名額40位滿額為止



明新科大(報名)



明新科大(簡章)

## 聯絡人

明新科技大學半導體學院  
半導體封裝測試類產線計畫辦公室  
何宗穎助理

TEL：03-5593142 #3270



## 明新科技大學112學年度教師產業研習 半導體封裝技術與核心實務培訓營招生簡章

主辦單位 明新科技大學

### 第一梯次(10 天，共 70 小時)

| 日期          | 時間          | 培訓內容             | 講員  | 服務機構及職稱                    |
|-------------|-------------|------------------|-----|----------------------------|
| 1/22<br>(一) | 08:30-12:00 | 半導體構裝技術的演變       | 羅勉成 | 世芯電子公司專案顧問                 |
|             | 13:00-16:30 | 認識晶圓切割機組成與功能     | 何信松 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/23<br>(二) | 08:30-12:00 | IC 產業發展願景        | 呂明峯 | 明新科技大學電子工程系教授              |
|             | 13:00-16:30 | 晶圓切割機人機介面參數設定    | 何信松 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/24<br>(三) | 08:30-12:00 | 半導體製程技術          | 陳炳茂 | 明新科技大學半導體與光電科技系副教授         |
|             | 13:00-16:30 | 晶圓切割機檢測與基本故障排除   | 何信松 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/25<br>(四) | 08:30-12:00 | 半導體製程技術          | 陳炳茂 | 明新科技大學半導體與光電科技系副教授         |
|             | 13:00-16:30 | 晶圓切割機實務程序操作      | 何信松 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/26<br>(五) | 08:30-12:00 | 半導體製程技術          | 陳炳茂 | 明新科技大學半導體與光電科技系副教授         |
|             | 13:00-16:30 | 認識固晶機組成與功能       | 林賢昇 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/29<br>(一) | 08:30-12:00 | 半導體封裝綜覽          | 蔡天寶 | 力成股份有限公司封裝製造暨設備整合處處長       |
|             | 13:00-16:30 | 固晶機人機介面參數設定      | 林賢昇 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/30<br>(二) | 08:30-12:00 | 基礎半導體封裝概論        | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | 固晶機檢測與基本故障排除     | 林賢昇 | 力成科技公司資深工程師                |
| 1/31<br>(三) | 08:30-12:00 | 半導體封裝第一階層連接方式    | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | 固晶機實務程序操作        | 林賢昇 | 力成科技公司資深工程師                |
| 2/1<br>(四)  | 08:30-12:00 | 典型封裝製程技術         | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | 認識 QFN 封裝設備組成與功能 | 鄭國偉 | 廣化科技股份有限公司業務處經理            |
| 2/2<br>(五)  | 08:30-12:00 | 3D 封裝製程          | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | QFN 封裝設備人機介面參數設定 | 陳慶恩 | 廣化科技股份有限公司關鍵技術研發處資深研發工程師   |

課程時間/  
課程名稱/  
師資



### 第二梯次(10 天，共 70 小時)

| 日期          | 時間          | 培訓內容              | 講員  | 服務機構                       |
|-------------|-------------|-------------------|-----|----------------------------|
| 7/1<br>(一)  | 08:30-12:00 | 半導體產業的發展與挑戰       | 呂明峯 | 明新科技大學電子工程系教授              |
|             | 13:00-16:30 | QFN 封裝設備檢測與基本故障排除 | 陳慶源 | 廣化科技股份有限公司<br>生產處資深工程師     |
| 7/2<br>(二)  | 08:30-12:00 | 先進封裝工程概論          | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | QFN 封裝設備實務程序操作    | 陳慶源 | 廣化科技股份有限公司生產處資深工程師         |
| 7/3<br>(三)  | 08:30-12:00 | 晶圓級封裝製程           | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | 認識打線機組成與功能        | 黃志賢 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/4<br>(四)  | 08:30-12:00 | 面板級封裝製程           | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | 打線機人機介面參數設定       | 黃志賢 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/5<br>(五)  | 08:30-12:00 | 先進封裝的發展趨勢         | 王欽宏 | 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組組長     |
|             | 13:00-16:30 | 打線機檢測與基本故障排除      | 黃志賢 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/8<br>(一)  | 08:30-12:00 | 先進封裝的技術挑戰         | 張香鉉 | 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理     |
|             | 13:00-16:30 | 打線機實務程序操作         | 黃志賢 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/9<br>(二)  | 08:30-12:00 | 先進封裝製程實務          | 張香鉉 | 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理     |
|             | 13:00-16:30 | 晶圓切割機操作能力檢測       | 何信松 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/10<br>(三) | 08:30-12:00 | IC 封裝產業環境汙染處理     | 江鍇帆 | 力成股份有限公司工安二部副部經理           |
|             | 13:00-16:30 | 固晶機操作能力檢測         | 林賢昇 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/11<br>(四) | 08:30-12:00 | 封裝產業廠務系統介紹        | 盧麒泰 | 力成股份有限公司廠務副部經理             |
|             | 13:00-16:30 | 打線機操作能力檢測         | 黃志賢 | 力成科技公司資深工程師                |
| 7/12<br>(五) | 08:30-12:00 | 半導體封裝製程學習評量       | 趙守嚴 | 明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長 |
|             | 13:00-16:30 | 半導體封裝設備核心實務評量     | 蔡天寶 | 力成股份有限公司封裝製造暨設備整合處處長       |



|             |                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>開課日期</b> | 第一梯次<br>113 年 1 月 22 日(一) 至 113 年 2 月 2 日(五)<br>每周一至周五 早上 8:30 至 16:30<br><br>第二梯次<br>113 年 7 月 1 日(一) 至 113 年 7 月 12 日(五)<br>每周一至周五 早上 8:30 至 16:30 |
| <b>開課地點</b> | 明新科技大學逢喜樓(209 教室)<br>半導體封裝測試類產線基地                                                                                                                    |
| <b>合作機構</b> | 明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室<br>工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組<br>力成科技股份有限公司<br>廣化科技股份有限公司                                                                              |
| <b>參與對象</b> | 高中職及大專院校教師                                                                                                                                           |
| <b>收費標準</b> | 免費                                                                                                                                                   |
| <b>招生人數</b> | 招生人數 40 人(校外 16 人、校內 24 人)                                                                                                                           |
| <b>報名網址</b> | <a href="https://forms.gle/Wjm3viG6Tv8pvD146">https://forms.gle/Wjm3viG6Tv8pvD146</a>                                                                |
| <b>結訓要求</b> | 每梯次缺席率達 25%以上(含)，不頒發當前梯次結業證書。                                                                                                                        |